DIN 32567-5:2015-06 (D)

Fertigungsmittel für Mikrosysteme - Ermittlung von Materialeinflüssen auf die optische und taktile dimensionelle Messtechnik - Teil 5: Ableitung von Korrekturwerten für optische Messgeräte

Inhalt		Seite	
Vorwo	ort	3	
Einleitung		4	
1	Anwendungsbereich	5	
2	Normative Verweisungen		
	Begriffe		
3			
4	Messbedingungen		
5 5.1	Einflussfaktoren bei optischen Oberflächenmessverfahren	5	
5.1 5.2	Allgemeines Materialspezifische Einflussfaktoren bei optischen Oberflächenmessverfahren		
5.2.1	Allgemeines		
5.2.2	Brechungsindex		
5.2.3 5.2.4	Änderung der PhasenlageÄnderung der spektralen Verteilung		
5.3	Gerätespezifische Einflussfaktoren bei optischen Verfahren		
5.3.1	Allgemeines		
5.3.2 5.3.3	Laterale AuflösungSpektrale Verteilung der Beleuchtung		
5.3.4	Beleuchtungsintensität		
5.3.5	Kohärenz		
5.3.6 5.3.7	Numerische AperturEmpfindlichkeit des Bildsensors		
	·		
6 6.1	Bestimmung der systematischen Abweichung topographisch gemessener Schichtdicker Bestimmung der effektiven numerischen Apertur		
6.2	Bestimmung der Veränderung der Phasenlage		
7	Korrekturverfahren für optische Messverfahren	12	
7.1	Weißlichtinterferometrie	12	
7.1.1	Allgemeines		
7.1.2 7.1.3	Materialpaarung: Schicht reflektierenden Materials auf transparentem Material		
7.2	Fokussierende Verfahren		
7.2.1	Allgemeines		
7.2.2	Materialpaarung: Schicht reflektierenden Materials auf transparentem Material		
7.2.3	Materialpaarung: Schicht transparenten Materials auf reflektierendem Material		
Anhang A (informativ) Bestimmung des Brechungsindex transparenter Schichten			
	ng B (informativ) Beispiele für Korrekturverfahren	17	
B.1	Transparente Schicht auf reflektierendem Substrat, fokussierendes Messverfahren, topographische Schichtdickenmessung	17	
Litoro	turhinweise		
∟itei d	lui iiii w cioc	10	